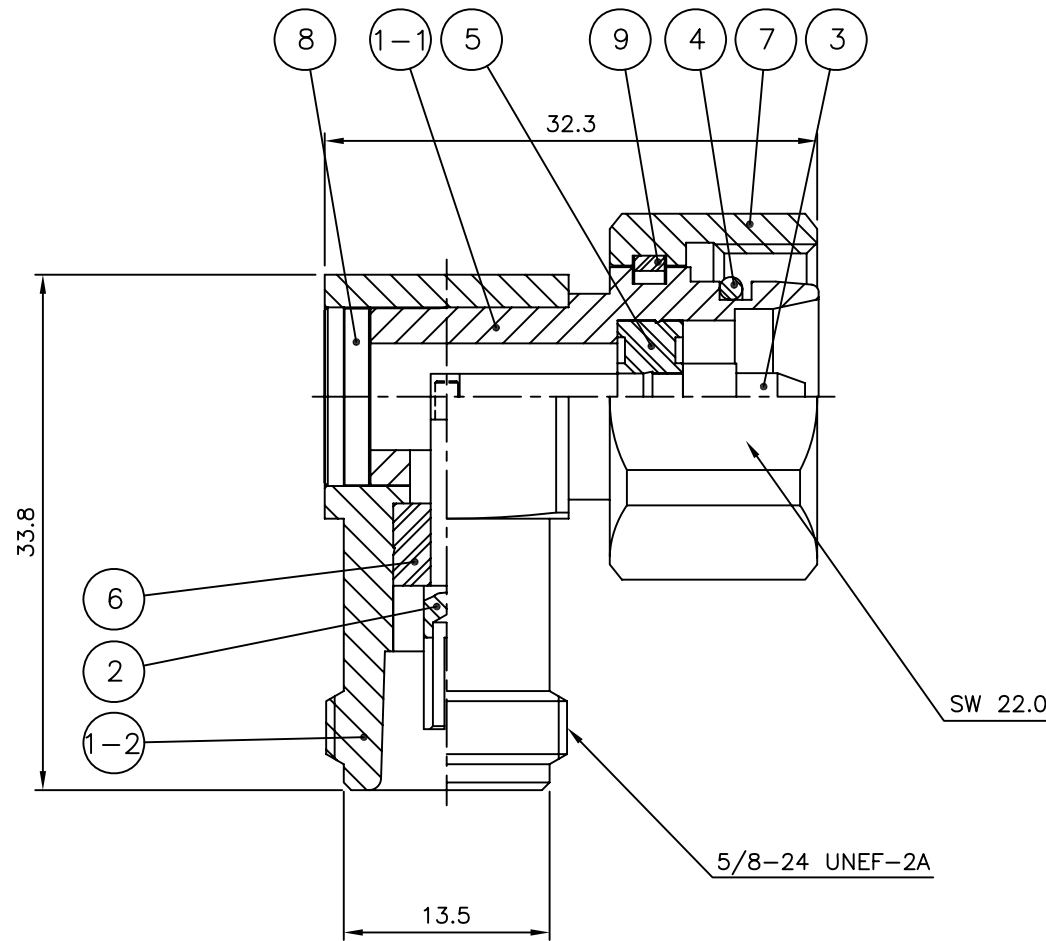


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	G.Y.KIM	I.C.KIM	2016.11.14.
1	[설변No.201804-0007] 조립 후 전장길이 상한치로 조립됨→조립공차 변경/Cover 조립 시 burr 발생으로 인한 치수 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.04.11.



9	SPRING RING	1	PBR	Nickel Plate	DSR00020-5/1
8	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	SUCO Plate (3μm)	DCO00107-5/2
7	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DCU02286-5/1
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02845-N/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02815-N/1
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00121-N/1
3	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Silver Plate (3μm)	DCT03782-5/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Silver Plate (3μm)	DCT02294-5/2
1-2	BODY (B)	1	MBsBD C3604BD-F	SUCO Plate (3μm)	DBB00455-5/1
1-1	BODY (A)	1	MBsBD C3604BD-F	SUCO Plate (3μm)	DBD04251-3/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

*조립방법

- 1-1번 BODY에 ⑤번 TEFLON ③번 PIN 순서로 조립한다.
- ③번 PIN을 ②번핀 조립방향으로 커팅부위를 -자 드라이버를 이용해 방향을 맞춘다.
- 1-2번 BODY에 ⑥번 TEFLON ②번 PIN 순서로 조립한다.
- ②번 ③번 PIN을 과납 및 냉땀을 주의하여 SOLDER 한다.
- ⑧번 COVER를 조립한다.
- ④번 GASKET 을 조립 후 ⑨번 RING+⑦번 CAP을 조립한다.

TOLERANCE	Decimal ±0.2 ±0.1	DATE 2018. 04. 11.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
	Angle ±1°	APPROVED BY	I.C.KIM					
MATERIAL	_____	CHECKED BY	TITLE 4.3/10 DIN50 (P) N50 (J) RA ADAPTOR					
		DRAWN BY				S.Y.EUN		
FINISH	_____	SCALE	UNIT		A4	DWG NO.	AD00594-7/1	
		2/1	mm			REVISION	1	SHEET